

Pressemitteilung, 13. Oktober 2009

Jahrestagung 2009 des Fraunhofer IISB

Erfolgreiche Kooperation für die europäische Halbleiterfertigung

Erfolge und Potentiale der Forschung und Entwicklung für die europäische Halbleiterfertigung – dieses Thema beleuchtet das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB anlässlich seiner Jahrestagung am 15.10.2009 in Erlangen.

Die Halbleiterfertigung in Europa sieht sich starker Konkurrenz aus den USA und vor allem dem asiatischen Raum ausgesetzt. Speziell im Bereich von extremen Massenprodukten wie Speicherbausteinen und Mainstream-Prozessoren wird die strategische Ausrichtung von Ländern wie Korea oder Taiwan deutlich. Doch auf dem Gebiet anwendungsspezifischer Technologien und Produkte, wie etwa für die Automobil-, die Maschinenbau- oder die Energiebranche, befinden sich europäische Halbleiterhersteller weltweit in der Spitzengruppe. Auch im Bereich der Entwicklung von Geräten und Anlagen für die Prozess- und Messtechnik, sowie effizienzsteigernder Entwicklungen für die Fertigungstechnik spielt Europa seine traditionelle Stärke im Maschinenbau und der Qualitätssicherung erfolgreich aus.

Um diese Position zu behaupten und neue Märkte zu erschließen, spielt eine starke Forschungslandschaft in Europa eine essentielle Rolle. Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Europa ist der Zugang zu Forschungskompetenz von extremer Bedeutung und in letzter Konsequenz entscheidend für den Markterfolg ihrer Produkte. Das Fraunhofer IISB ist ein starker Partner in der anwendungsorientierten Forschung auf dem Gebiet der Geräte und Methoden für die Halbleiterfertigung. Das Institut ist hier mit internationalen Partnern auf vielfältige Weise verbunden, oft als Initiator und Koordinator europäischer Verbundprojekte.

Auf der Jahrestagung des Fraunhofer IISB stehen die Ergebnisse erfolgreicher Kooperationen und der Ausblick auf zukünftige Forschungsaktivitäten im Mittelpunkt. Themen sind hier zum Beispiel der Test und die Optimierung von Halbleiterfertigungsgeräten, Ansätze zur effizienten und ressourcenschonenden Fertigung, der Einsatz modernster Messtechnik und Analytik, innovative simulationsgesteuerte Geräteentwicklung oder – mit Blick in die Zukunft – Vorbereitungen zur Chip-Fertigung auf Siliciumscheiben mit 450mm Durchmesser.

Organisiert wird die Jahrestagung von der Abteilung für Halbleiterfertigungsgeräte und -methoden des Fraunhofer IISB. Das Institut ist auf diesen Gebieten das europäische Kompetenzzentrum mit den Schwerpunkten Geräte- und Prozessautomatisierung, Kontaminationsuntersuchung, Ausbeuteerhöhung, Fertigungssteuerung und Produktivität.

Die Jahrestagung des Fraunhofer IISB ist öffentlich, die Teilnahme nach Anmeldung kostenfrei.

Weitere Informationen: www.iisb.fraunhofer.de → **Veranstaltungen**

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Lothar Pfitzner
Fraunhofer IISB
Schottkystraße 10, 91058 Erlangen, Germany
Tel. +49-9131-761-110
Fax +49-9131-761-112
lothar.pfitzner@iisb.fraunhofer.de

Fraunhofer IISB:

Das 1985 gegründete Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB betreibt angewandte Forschung und Entwicklung auf den Gebieten der Mikro- und Nanoelektronik, Leistungselektronik und Mechatronik. Mit Technologie-, Geräte- und Materialentwicklungen für die Nanoelektronik sowie seinen Arbeiten zu leistungselektronischen Systemen für Energieeffizienz, Hybrid- und Elektroautomobile genießt das Institut internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Vertragsforschung für die Industrie und öffentliche Einrichtungen. Neben seinem Hauptsitz in Erlangen hat das IISB zwei weitere Standorte in Nürnberg und Freiberg. Das IISB arbeitet eng mit dem Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente an der Universität Erlangen-Nürnberg zusammen.